PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

10-197559

(43) Date of publication of application: 31.07.1998

(51)Int.CI.

G01R 1/073 G01R 1/067

G01R 31/02 G01R 31/26

(21)Application number: 09-016026

(71)Applicant: ORGAN NEEDLE CO LTD

(22) Date of filing:

14.01.1997 (72)Inven

(72)Inventor: MARUTA HIROSHI

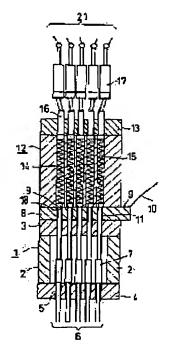
TSUTSUMI YUTAKA NAGAHARI NOBORU NAKAJIMA ETSUSEI

(54) TEST HEAD WITH SWITCH PROBE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a test head equipped with switch probe capable of enhancing the effectiveness in the maintenance works and allowing a narrow pitch arrangement.

SOLUTION: In a plunger guide member 1, plungers 6 are inserted in a matrix form, and a contact base board 8 is installed on the surface of the plunger guide member 1, and on the surface of the board 8, conductive patterns 9 are formed in rows, and a plurality of through holes 11 for insertion of plungers 6 are provided in the conductive patterns 9 at certain intervals. A spring guide member 12 is installed on the surface of the contact base board 8, and inside it coil springs 15 are laid in a matrix form, and conductive balls 18 for contacting of the patterns 9 at the periphery of the through hole 11 are installed in the lower part of each coil spring 15. Because the patterns 9 and balls 18 function as switch contacts, a narrow pitch arrangement can be introduced even when a number of pins are to be examined.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-197559

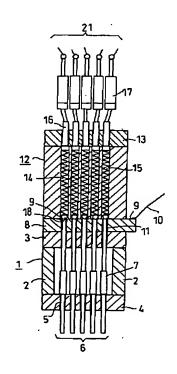
(43)公開日 平成10年(1998)7月31日

(51) Int.Cl. 6	識別記号	F I
G01R 1/	073	G 0 1 R 1/073 D
1/	067	1/067 C
31/	02	31/02
31/26	26	31/26 J
		審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 5 頁
(21) 出願番号	特顧平9-16026	(71)出願人 000104021
		オルガン針株式会社
(22) 出顧日	平成9年(1997)1月14日	長野県上田市大字前山 1 番地
		(72)発明者 丸田 寛
		長野県上田市大字前山1番地 オルガン
		株式会社内
		(72) 発明者 堤 豊
		長野県上田市大字前山1番地 オルガン
		株式会社内
		(72)発明者 長張 登
		長野県上田市大字前山1番地 オルガン
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 薬師 稔 (外1名)
		最終頁に統・

(54) 【発明の名称】 スイッチプローブを備えたテストヘッド

(57)【要約】

【課題】 狭いビッチで配列することができ、しかも、メンテナンス作業などの作業性を向上させることのできるスイッチプローブを備えたテストへッドを提供する。 【解決手段】 ブランジャガイド部材1にプランジャ6をマトリックスに挿通し、プランジャガイド部材1の表面に接点基板8を取り付けてその表面には導電パターン9を複数列形成し、各導電パターン9にブランジャ6 貫通用の貫通孔11を間隔をおき複数穿孔する。また、接点基板8の表面にスプリングガイド部材12を設置してその内部にはコイルスプリング15をマトリックスに並べ、各コイルスプリング15の下部に貫通孔11周縁の導電パターン9接触用の導電ボール18を取り付ける。 導電パターン9と導電ボール18がスイッチの接点として機能するから、多数のピンなどを調べる場合でも狭いビッチで配列できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 多数のプランジャを列設したプランジャ ガイド部材と、一端に導電ボールを、他端にはターミナ ルをそれぞれ備えたスプリングを多数列設したスプリン グガイド部材と、前記プランジャの頭部が挿入される質 通孔と導電パターンを有する接点基板とを備え、前記プ ランジャガイド部材とスプリングガイド部材の間に接点 基板を介在させて各プランジャの頭部が導電ボールに当 接できるようにしたことを特徴とするスイッチプローブ を備えたテストヘッド。

1

【請求項2】 前記接点基板の各導電パターンのリード とターミナルのリードとをダイオードを介してダイオー ドマトリックス回路を構成し、各リードをインターフェ イスに接続してスイッチ状態を検出する検出回路を備え てなる請求項1記載のスイッチプローブを備えたテスト ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体パッケージ のピンの欠損やプリント基板上の部品の有無や検査をス 20 イッチプローブを使用して行うスイッチプローブを備え たテストヘッドに関するものである。

[0002]

【従来の技術】テストヘッドは多数のスイッチプローブ を備えて半導体パッケージのピンの欠損、又はプリント 基板上の部品の有無や検査などに使用されるが、従来の プローブは、図6に示すように、細長い円筒形のスリー ブ22の開口上部から内部に筒形の絶縁体23を嵌着し てこの絶縁体23には棒形の第一のプローブ24をコイ ルスプリング25を介し往復動可能に挿入するととも に、コイルスプリング25の上部にリードライン26を ターミナル27を介して接続し、スリーブ22の開口下 部には棒形の第二のプローブ28をコイルスプリング2 9を介し往復動可能に挿入し、第一のプローブ24の下 端と第二のプローブ28の上端の間に小さなギャップを 形成するようにしている。

【0003】したがって、例えば図示しないプリント基 板上の部品の有無をテストヘッドで検査する場合には、 部品にスイッチプローブの第二のプローブ28の拡径下 部を押し当てれば良い。こうすれば、第一のプローブ2 4の拡径下部と上昇した第二のプローブ28が接触導通 し、検査回路が閉路してプリント基板上の部品の有無を 検査するととができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、半導体パッ ケージのピンを調べる場合、指定されたビッチで数百本 という多数のスイッチプローブを備えたテストヘッドを 必要とする。しかしながら、従来のテストヘッドは、上 記したようにスリーブ22に絶縁体23を同軸構造に嵌 着しているので、スイッチプローブの外径が大きくな

り、狭いピッチの配列がきわめて困難であるという問題 があった。また、スイッチプローブは、ピン数以上の多 数のリードライン26を必要とするので、テストヘッド のメンテナンス作業の作業性が悪いという問題があっ

【0005】本発明は、上記問題に鑑みてなされたもの で、狭いピッチで配列することができ、しかも、メンテ ナンス作業などの作業性を向上させることのできるスイ ッチプローブを備えたテストへッドを提供することを目 的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1記載の発明においては、多数のプランジャ を列設したプランジャガイド部材と、一端に導電ボール を、他端にはターミナルをそれぞれ備えたスプリングを 多数列設したスプリングガイド部材と、前記プランジャ の頭部が挿入される貫通孔と導電パターンを有する接点 基板とを備え、前記プランジャガイド部材とスプリング ガイド部材の間に接点基板を介在させて各プランジャの 頭部が導電ボールに当接できるようにしている。なお、 前記接点基板の各導電パターンのリードとターミナルの リードとをダイオードを介してダイオードマトリックス 回路を構成し、各リードをインターフェイスに接続して スイッチ状態を検出する検出回路を備えると良い。

【0007】請求項1記載の発明によれば、半導体バッ ケージの多数のピンなどを調べるには、ピンにプランジ ャを接触させる。すると、各プランジャが往動して導電 パターンから導電ボールを離し、検査回路が開路して半 導体バッケージのピンを検査できる。また、ピンからプ ランジャを離すと、スプリングの復帰作用でプランジャ が復動して導電パターンに導電ボールを接触させ、検査 回路が閉路する。とのように請求項1記載の発明は、導 電バターンと導電ボールとをスイッチの接点としてい る。

【0008】また、請求項2記載の発明によれば、例え ば、ダイオードマトリックス回路を行又は列毎に接点基 板の各導電パターンにリードを介して接続し、列又は行 ごとに同一のラインで接続する。また、多数の導電パタ ーンをインターフェイスの出力側を介して接続し、多数 40 のダイオード結線ラインをインターフェイスの入力側を 介して接続する。そして、例えば、接点基板の端の導電 パターンをLレベルに、他の導電パターンをHレベルに それぞれ設定し、ダイオードのラインD₁~D₂までの 信号を調べる。

【0009】すると、導電パターンとラインの交点のス イッチがONの場合にはLレベルに、OFFの場合には Hレベルになる。次いで、接点基板の端から次の列の導 電パターンをLレベルに、他の導電パターンをHレベル にそれぞれ設定し、ダイオードのライン側の信号を調 50 べ、以下、上記作業を適宜繰り返す。とうすれば、スイ

10

ッチの状態、すなわち、どのブランジャが往跡している かを検出できる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面を 参照して説明する。本実施形態におけるスイッチプロー ブを備えたテストヘッドは、図1に示すように、プラン ジャガイド部材1に多数のプランジャ6を上下動可能に **挿通し、プランジャガイド部材1の上面に接点基板8を** 取り付けてその表面にはスプリングガイド部材12を設 置し、多数のプランジャ6における任意のプランジャ6 10 の上昇を検出回路19で検出するようにしている。

【0011】プランジャガイド部材1は、ギャップを介 して左右に並ぶ一対の縦部材2を備え、この一対の縦部 材2の上部間及び下部間にはプラスチックガイド板3、 4がそれぞれ水平に架設されている。各プラスチックガ イド板3、4にはプランジャ6用のガイド孔5がマトリ ックス(本実施形態では5行5列)に並べて穿孔され、 上部のプラスチックガイド板3における多数のガイド孔 5と下部のプラスチックガイド板4における多数のガイ ド孔5とが相互に対向するようになっている。

【0012】また、ブランジャ6は、金属、セラミッ ク、又は合成樹脂などを材料として丸棒形に構成され、 その表面が絶縁コーティングされており、一対のプラス チックガイド板3、4のガイド孔5に適当なギャップを 介してスライド可能に挿入される。 プランジャ6の中央 部付近には拡径の抜け防止部7材が形成され、この抜け 防止部7材が下部のプラスチックガイド板4のガイド孔 5に係止して脱落を防止するよう作用する。

【0013】また、接点基板8は、例えば、紙エポキ シ、紙フェノール、ガラス布エポキシ、ガラス布ポリイ ミド、ガラス布テフロン、BTレンジ、又はポリエステ ルなどで構成され、図2に示すように表面に銅製の導電 パターン9が平行に並べて多数列(本実施形態では5 列) 形成されている。各導電パターン9は、その表面に 導電性を向上させる金めっき(図示せず)が施され、側 端部にはリードライン10が接続されている。また、接 点基板8は、プランジャ6の頭部に貫通される貫通孔1 1が導電パターン9を貫通して多数(本実施形態では1 列につき5個、全体で25個)間隔をおいて穿孔されて おり、この多数の貫通孔11が各プラスチックガイド板 40 3、4のガイド孔5と相互に対向するようになってい る。

【0014】また、スプリングガイド部材12は、合成 樹脂などを材料としたほぼ箱形に形成され、その上部に 板形のふた13が着脱自在に取り付けられており、内部 には多数(本実施形態では25個)のばね孔14が並べ て設けられるとともに、この多数のばね孔14が接点基 板8の多数の貫通孔11と相互に対向するようになって いる。各ばね孔14にはブランジャ6に対向するコイル スプリング15が縦に内蔵され、各コイルスプリング1 50 押し上げられているかをコンピュータで容易に検出する

5の上部にはふた13を貫通するターミナル16を介し てダイオード17が、下部には貫通孔11の周縁の導電 バターン9に接触する金属製の導電ボール18がそれぞ れ取り付けられている。

【0015】さらに、検出回路19は、図3や図5に示 すように、25個のダイオード17が5行5列のマトリ ックスに並んだダイオードマトリックス回路20を備 え、とのダイオードマトリックス回路20が行毎に接点 基板8のリードライン10で接続されており、列毎に同 一の21ラインで接続されている。複数のリードライン 10は図示しないコンピュータにパラレルインターフェ イス(図示せず)の出力側を介して接続されている。そ して、複数のライン21は、コンピュータにパラレルイ ンターフェイスの入力側を介して接続されている。

【0016】上記構成において、図示しない半導体バッ ケージの多数のピンを調べるには、多数のピンにスイッ チプローブを備えたテストヘッドのプランジャ6の下部 をそれぞれ押し当てれば良い。すると、各プランジャ6 が上昇して貫通孔11を閉そくする導電ボール18を押 し上げ、貫通孔 1 1 の周縁の導電バターン 9 から導電ボ ール18が離れ、検出回路19が開路(図4(b)参 照) して半導体パッケージの多数のピンを検査すること ができる。また、多数のピンからテストヘッドのプラン ジャ6の下部をそれぞれ離すと、圧縮したコイルスプリ ング15の復帰動作で各プランジャ6が下降して貫通孔 11の周縁の導電パターン9に導電ボール18を接触さ せ、検出回路19が閉路する(図4(a)参照)。

【0017】上記構成によれば、導電パターン9と導電 ボール18をスイッチの接点としているので、半導体バ ッケージの多数のピンを調べる場合でも狭いピッチの配 列がきわめて容易に期待できる。また、ダイオードマト リックス回路20を備えた検出回路19を使用するの で、どのプランジャ6が押し上げられて開路しているか をきわめて容易に検出することができる。

【0018】との点につき、図5を参照して説明する と、例えば、接点基板8のリードラインし、をLレベル に、リードラインし、~し、をHレベルにそれぞれ設定 し、ダイオード17のラインD、~D、までの信号を調 べる。リードライン10とライン21の交点のスイッチ がONの場合にはLレベルに、OFFの場合にはHレベ ルになる。次いで、接点基板8のリードラインし、をし レベルに、他のリードラインL、、L、、L、、L、を Hレベルにそれぞれ設定し、ダイオード17のラインD 、~D、までの信号を調べ、以下、上記作業を繰り返 す。

【0019】とのように接点基板8の複数のリードライ ンし、~し、を順番にしレベルにしながらダイオード1 7のラインD、~D、側の信号を調べることを繰り返せ は、スイッチの状態、換言すれば、どのプランジャ6が 5

ことができる。さらに、ダイオードマトリックス回路20の使用で25本のプランジャ6の助きを10本のリードライン10及びライン21で簡単に検出することが可能になる。 通常、この種の装置ではテストヘッドが助作して検査するので、助作に伴う断線事故が多い。しかしながら、本実施形態によれば、リードライン10及びライン21の減少により、断線事故を有効に防止抑制することができるとともに、メンテナンスの作業性の大幅な向上が期待できる。なお、この効果はピン数が多くなるほど大きくなる。

【0020】なお、上記実施形態によれば、ブランジャ6及びダイオード17を5行5列のマトリックスに並べたものを示したが、なんらこれに限定されるものではなく、ブランジャ6及びダイオード17の行数、列数、又は数を適宜変更することができるのはいうまでもない。【0021】

【発明の効果】以上のように請求項1記載の発明によれば、狭いピッチで配列することができ、しかも、メンテナンス作業などの作業性を向上させることができるという効果がある。さらに、請求項2記載の発明によれば、スイッチの状態、すなわち、どのブランジャが動作して検出回路が開路したかを検出することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1 】本発明に係るスイッチプローブを備えたテスト ヘッドの実施の形態を示す断面正面図である。

【図2】図1の接点基板を示す平面図である。

【図3】図1の多数のダイオードの結線を示す平面図で*

*ある。

【図4】図1のプランジャの動作状態を示す説明図で、 (a) 図は押し上げられたプランジャが元の位置に復帰 のた状態を示す版画説明図 (b) 図はプランジャが押

した状態を示す断面説明図、(b)図はプランジャが押 し上げられた状態を示す断面説明図である。

【図5】本発明に係るスイッチプローブを備えたテスト ヘッドのダイオードマトリックス回路を示す回路構成図 である。

【図6】従来のテストヘッドのスイッチプローブを示す 断面正面図である。

【符号の説明】

1…プランジャガイド部材

3、4…プラスチックガイド板

5…ガイド孔

6…プランジャ

8…接点基板

9…導電パターン

10…リードライン(リード)

11…貫通孔

20 12…スプリングガイド部材

14…ばね孔

15…コイルスプリング(スプリング)

17…ダイオード

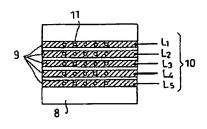
18…導電ボール

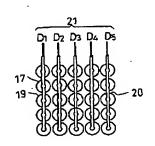
19…検出回路

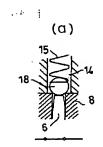
20…ダイオードマトリックス回路

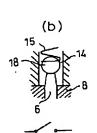
21…ライン

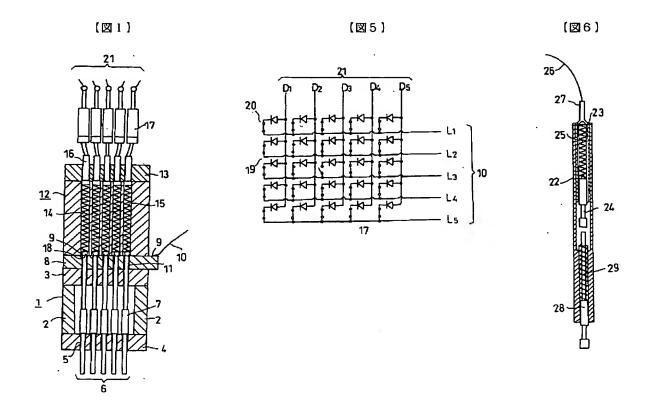
[図2] 【図3】 【図4】











フロントページの続き

(72)発明者 中島 悦成 長野県上田市大字前山 l 番地 オルガン針 株式会社内